

開示の要約 (ABSTRACT OF THE DISCLOSURE)

被パターニング薄膜の表面に、少なくとも絶縁性有機膜及び導電性膜を成膜し、成膜した導電性膜上にレジスト膜を形成した後、EB描画法によりレジスト膜をパターニングし、パターニングしたレジスト膜をマスクとして被パターニング薄膜をドライエッチングによりパターニングした後、上述の少なくとも1つの剥離可能な膜を除去する。